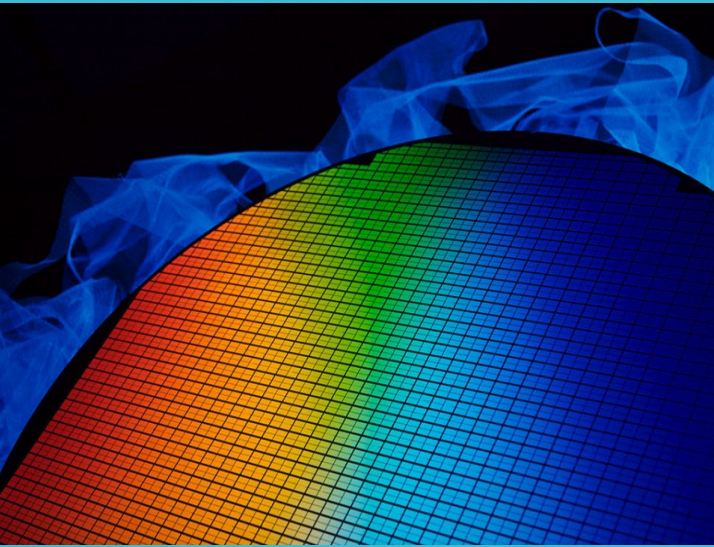


第3回3DHIアライアンス公開研究会（仮）

- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| <u>13:00~13:05</u> | 「オープニング」 | 3DHI |
| <u>13:05~13:30</u> | 「画像処理関連についてのご紹介」 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 |
| <u>13:30~13:55</u> | 「3次元実装を支援するチップレット・先端パッケージング・システム協調設計環境」 | 株式会社 図研 |
| <u>13:55~14:20</u> | 「半導体の進化に伴う新たな課題解決に資する神戸製鋼グループの多様な技術群」 | 株式会社 神戸製鋼所 |
| <u>14:20~14:45</u> | 「低温Cu-Cu接合用硫酸銅めっき皮膜」 | 奥野製薬工業株式会社 |
| <u>14:45~15:30</u> | 休 憩 及 び 展 示 会 場 見 学 | |
| <u>15:30~15:55</u> | 「TOTOセラミック製品のご紹介」 | TOTO株式会社 |
| <u>15:55~16:20</u> | 「角型シリコン基板を用いたソリューションの紹介」 | 三菱マテリアル株式会社 |
| <u>16:20~16:45</u> | 「RF向けガラス配線基板と個片化技術の開発」 | TOPPAN株式会社 |
| <u>16:45~17:10</u> | 「TSVおよびTGV用硫酸銅めっきについて」 | 株式会社 JCU |
| <u>17:10~17:35</u> | 「高精度接合を実現するDTB」 | タツモ株式会社 |
| <u>17:35~17:40</u> | 「クロージング」 | 3DHI |
| <u>17:40~18:40</u> | 展示会場見学 | |



第3回公開研究会



第3回3DHIアライアンス公開研究会（仮） テーブル展示企業一覧

講演及びテーブル展示企業

- ① 東京エレクトロンデバイス株式会社
- ② 株式会社 図研
- ③ 株式会社 神戸製鋼所
- ④ 三菱マテリアル株式会社
- ⑤ 奥野製薬工業株式会社
- ⑥ TOPPAN株式会社
- ⑦ 株式会社 JCU
- ⑧ タツモ株式会社

テーブル展示企業

- ⑨ パナソニックホールディング
- ⑩ 株式会社 KRI
- ⑪ ギガフォトン株式会社
- ⑫ 株式会社 D-process
- ⑬ 大塚電子株式会社
- ⑭ テクノホライゾン株式会社
- ⑮ リンテック株式会社



第3回公開研究会

